

メモリ用ヒートシンク

TK-HM3

特長

取付け簡単、メモリ用ヒートシンク

仕様

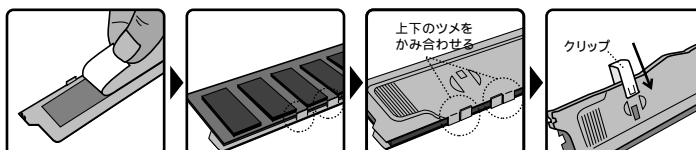
材質:アルミ
サイズ:W136.5×D26.6×H5.7mm
重量:17g

製品内容

ヒートシンク本体×1
熱伝導シート(W115×D15×H1mm)×1
小型ヒートシンク(W50×D18×H4mm)×2

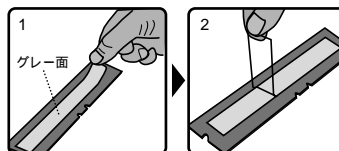
取付け方法

本製品の内側に貼ってあるシート(熱伝導シート)の保護シールをはがします。
本製品のツメに合わせて、メモリを固定してください。
上下のツメをかみ合わせて、本製品でメモリを挟みます。
クリップで2箇所を固定して完了です。



片面実装タイプ(チップが片面だけに搭載されている)メモリの場合は、密着度を高めるため本製品で挟む前に、付属の熱伝導シートをメモリに貼付しておいてください。

- 1 メモリチップが搭載されていない面に、熱伝導シートの白いシールをはがして貼ります(グレー面が上になります)。
- 2 グレー面の透明シールをはがします。この後、本製品で挟んでください。



⚠ 使用上のご注意

メモリなどの電子部品に触れる前には必ず広い金属面に触れるなどし、身体にたまった静電気を逃してから作業を行ってください。
メモリの取り扱いについては十分ご注意ください。

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター 岡山市田町1-10-1 tel:086-223-3311
東京サプライセンター 東京都品川区南大井6-5-8 tel:03-5763-0011

www.sanwa.co.jp

記載の社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。

03/11/MINT